



YOUR PROFESSIONAL PARTNER IN RFIC PACKAGE & FINAL TESTING





01 公司簡介

02 核心業務



CONTENTS | 01

公司簡介

公 司 簡 介

深耕射頻技術， 築基科技未來

我們的經營理念：誠如金石，意若善水，精勤向上

我們秉持誠信與用心服務的初衷，全面整合 RF 射頻技術與先進工程實力，不斷追求技術的極致完美，為客戶交付最佳的客製化解決方案。



臻品科技 歷史里程碑

2020

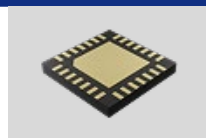
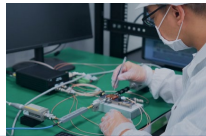


投資 Ginpintec 以開拓專業的射頻（RF）晶圓級量產測試服務；建立萬級無塵室，並成功開發脈衝式射頻（Pulsed-RF）AM-PM 量測技術。

2020

2021

透過整合前沿的 EVB 開發實力，臻品科技致力於為客戶打造卓越的高功率終測服務。

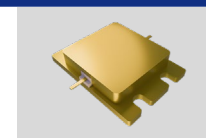
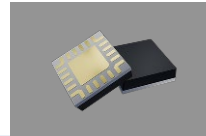


引進先進封裝設備，全面拓展氣腔式 QFN 封裝服務。

2022

2023

推出 QFN 封裝與測試量產服務，為客戶提供全面的一站式晶圓後段服務。



拓展至高功率 HPA 凸緣型封裝服務，並提供多元化的設備解決方案。

2024

2025

遷至現今的汐止廠房，全面整合廠務與辦公營運以強化企業綜效。



導入先進的 ATE 半自動系統，大幅提升產能，確保為客戶提供快速且可靠的交付服務。

2025

2025

我們的實驗室 & 工作室

臻品科技實驗室

- 專業射頻晶圓量測服務



內湖區

Taipei Metropolitan Area



誠意辦公室

汐止區

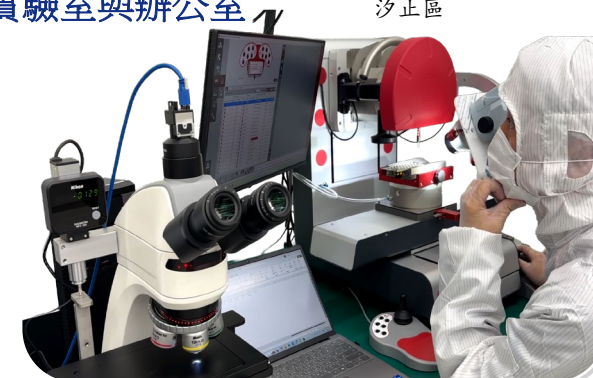
- R&D 研發部門
- 供應管理部
- 業務部
- 行政部
- 採購部
- 品管部
- 行銷部



臻品科技實驗室與辦公室

汐止區

- 封裝
- 最終測試

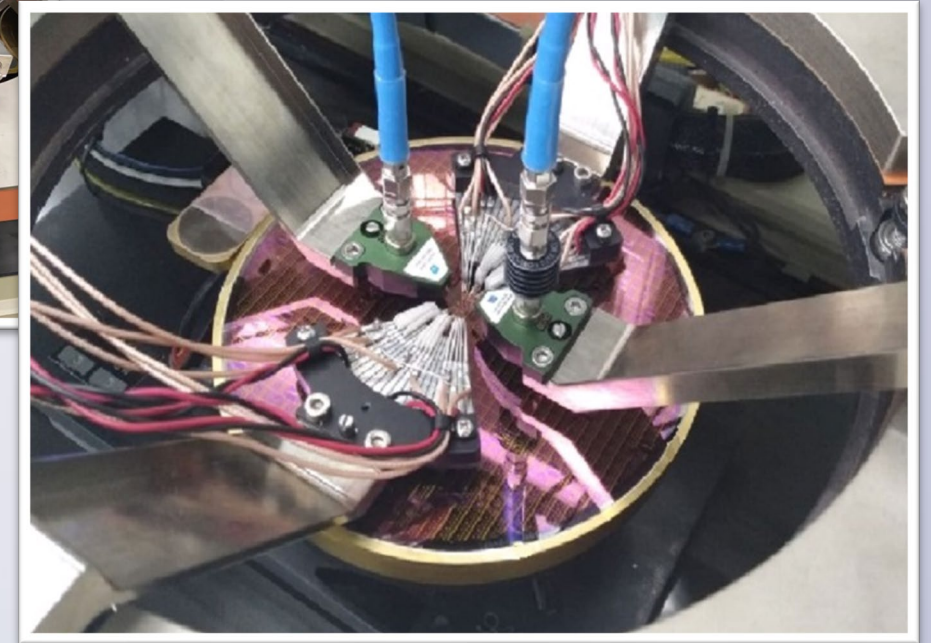
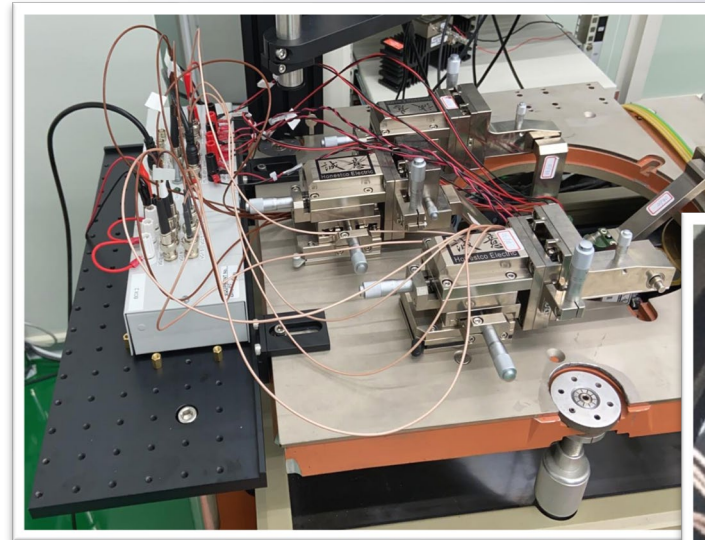


CONTENTS | 03



核心業務



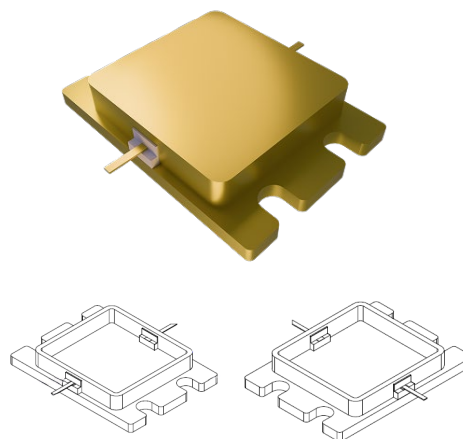


- 臻品量測服務
- 四點同時探針量測
- 標準 RF 射頻探針 2 支
- 客製化 DC 直流探針 2 支
- 量產級量測
- 10,000 級無塵室
- 待測元件功能：功率放大器



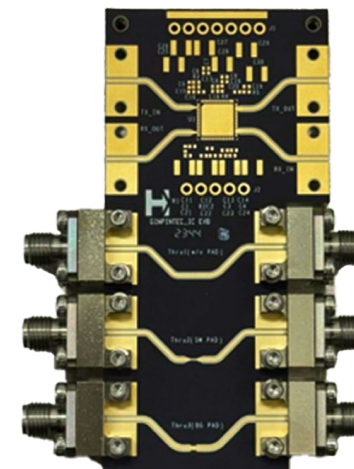
射頻晶圓級測試

- 支援 4 吋及 6 吋晶圓
- 支援 1/4 及半片晶圓量測
- 支援單一或多元件測試
- 具備四向探針量測能力
- 高功率脈衝量測系統（最高可達 92 GHz）



封裝

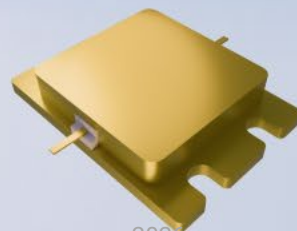
- 覆晶封裝
- 高功率封裝
- 氣腔式 QFN 封裝
- 模壓型 QFN 封裝



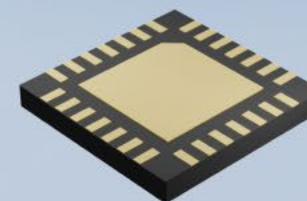
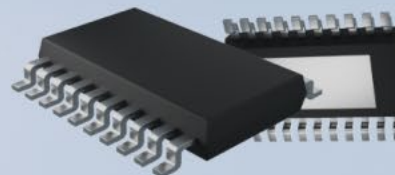
最終測試

- 自主研發評估板（EVB）與測試座
- COB（板上晶片）量測技術
- 高功率脈衝量測系統（最高可達 92 GHz）
- 支援 5% 工作週期測試條件





2026



成功案例



1.封裝與最終測試(7×7 QFN 48L)

- 5.5 GHz, GaN, core chip
- HPA (47dBm) / LNA, 2 dies in single QFN.
- Overall FT yield > 95%.

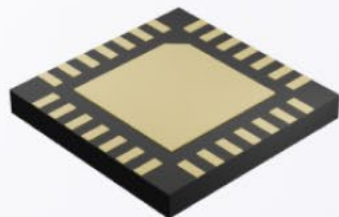
2.封裝與最終測試(TSSOP20)

- 60W HPA, 2dies
- Final testing on-going

3.封裝與最終測試(Heat sink)

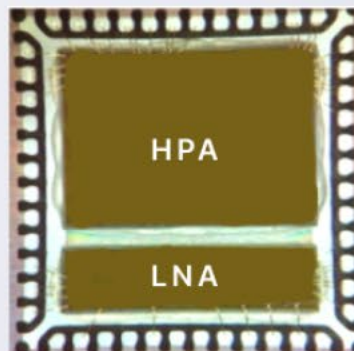
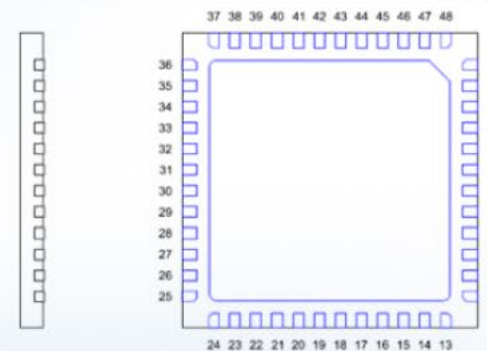
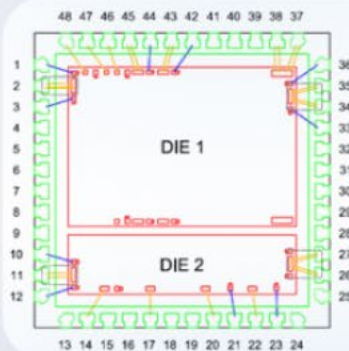
- 400W GaN HPA

封裝與最終測試 (7X7 QFN 48L)



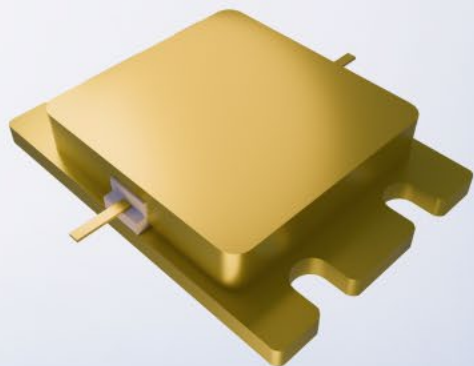
Package Type	48L QFN 7x7 mm / 0.50 mm PITCH
Package Thickness	0.60 mm MAX
Die Type	0.25um GaN pHEMT
Die Size	5.4 x 3.8 mm and 5.4 x 1.4 mm
Die Thickness	3 mil
Mold Material	Sumitomo G770HJ
Die Attach Material	Sintered Ag, Namics H9890-11
Wire	Ø 1.0 mil / Au
MSL Rating	MSL 3
Status	Qualified, in MP

FEM in RADAR System

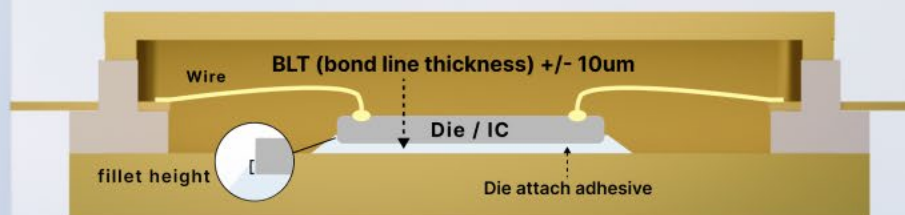


Excellent epoxy coverage on each side of the die

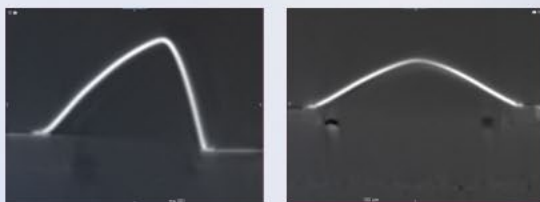
封裝與最終測試 (Heat Sink)



BLT Control



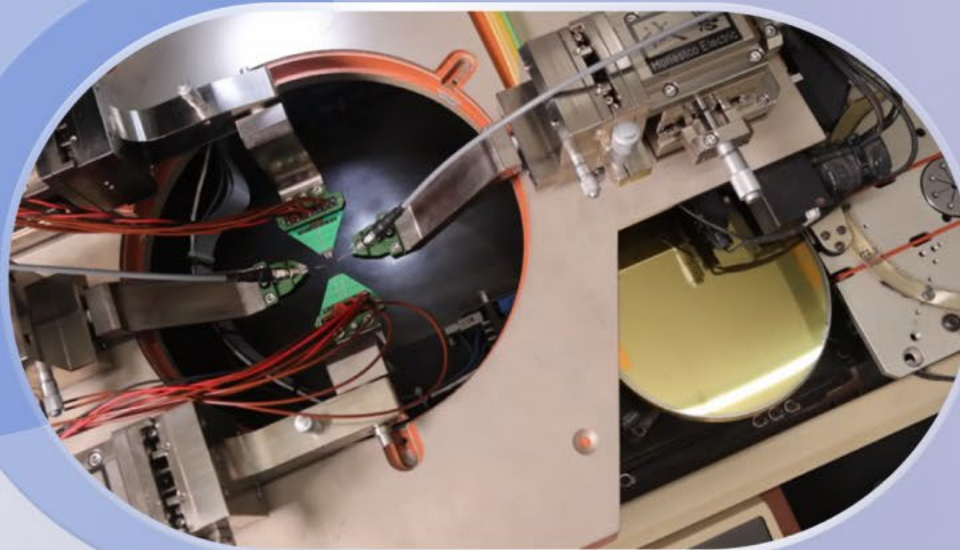
X-Ray



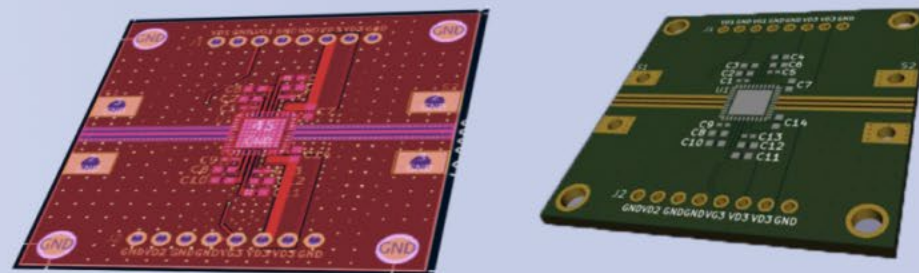
Wire Bonding



高功率 TX/RX 模組自動化量測系統

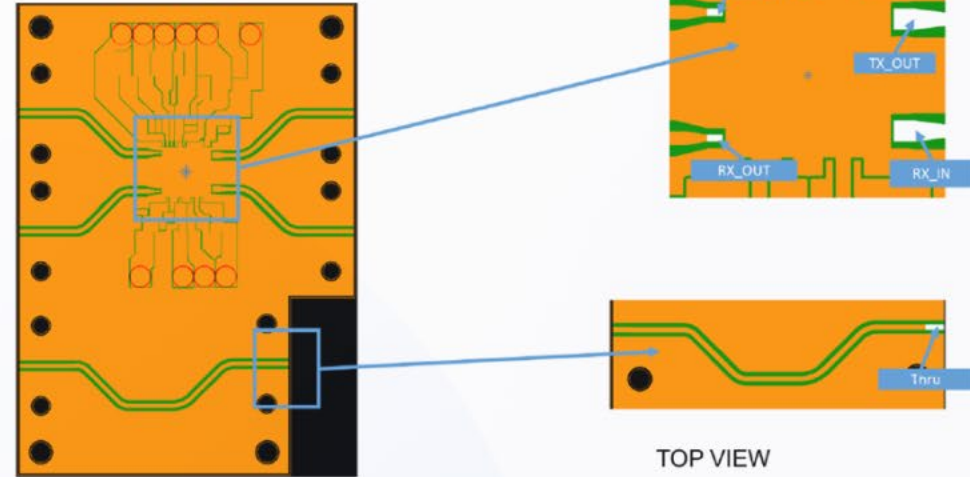


高功率 PA 評估板

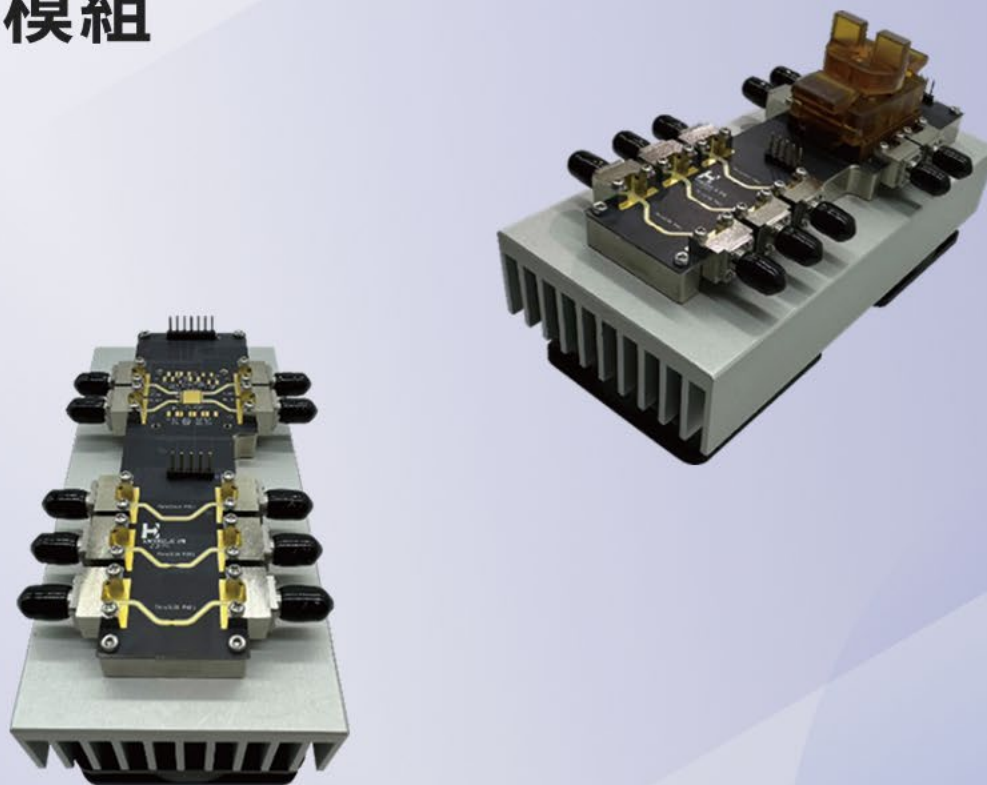


自研RF EVB設計 與開發服務

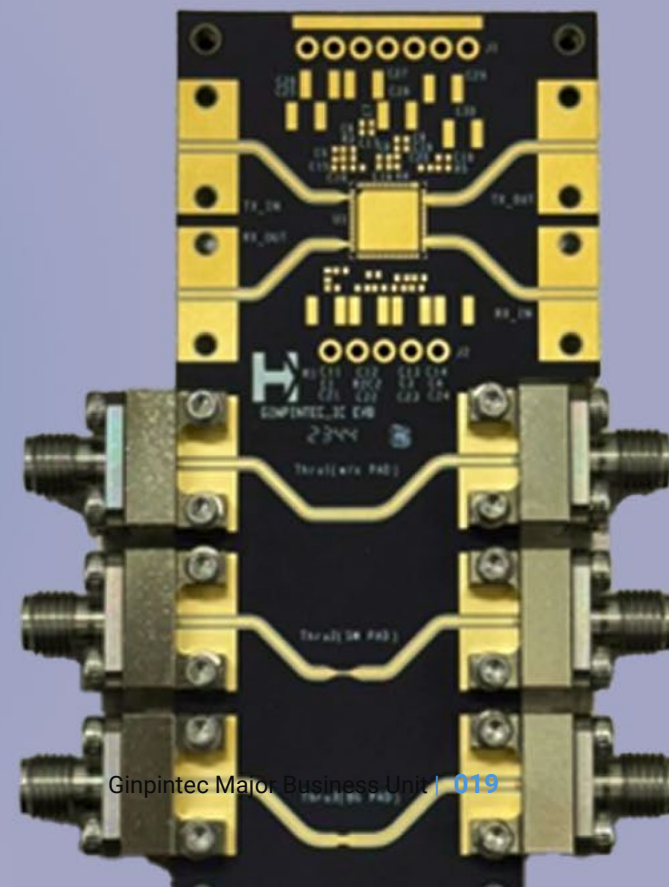
Pin Define



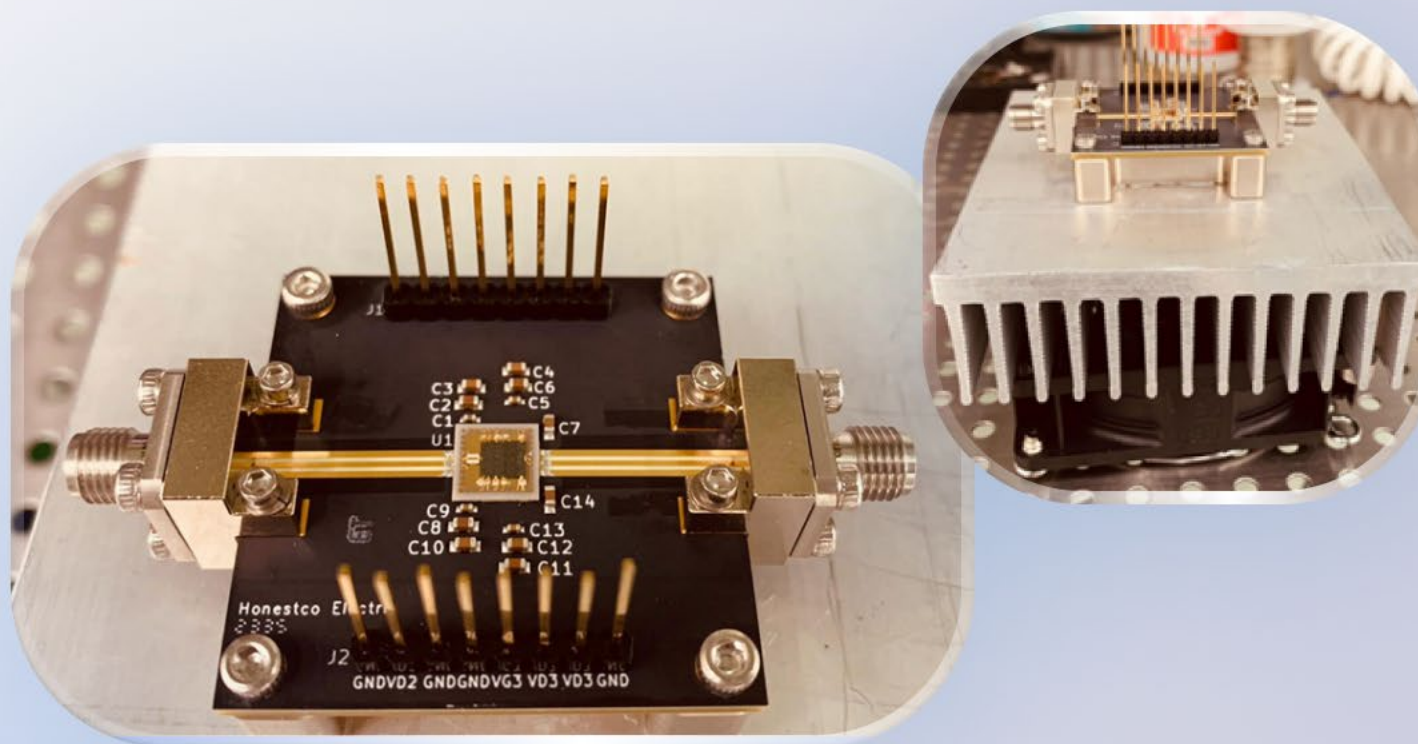
EVB 模組



EVB 模組



高功率 PA EVB模組





Thank You!